

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	共 42 家机构，参会机构名单详见附表。
会议时间	2025 年 10 月 13 日-2025 年 10 月 15 日
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 发展规划处副处长 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	董秘介绍 2025 年上半年业绩情况： 2025 年上半年实现营业收入约 52 亿，较去年同期增长 18.21%；实现净利润 2.32 亿，较去年同期增长 19.07%；综合毛利率为 25.76%。 从制程节点分类看，55nm 占主营业务收入的比例提升至 10.38%，40nm 开始贡献营收，中高阶制程营收贡献不断增加；从应用产品分类看，DDIC 占主营业务收入的比例下降至 60.61%，CIS 占主营业务收入的比例上升至 20.51%，产品结构继续优化。 问题 1：公司目前的研发进展如何？ 答复：目前，公司 55nm 堆栈式 CIS 芯片已实现全流程生产；55nm 逻辑芯片实现小批量生产；40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现批量生产；28nm 逻辑芯片持续流片。 问题 2：请问公司在汽车芯片制造能力上的最新进展？ 答复：目前，在车用芯片领域，公司已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证，部分车规级 DDIC 和 CIS 平台已通过 AEC-Q100 认证。

	问题 3：请问公司现在产能利用率如何？ 答复：公司近期各项业务经营正常，产能利用率仍处于高位水平。 问题 4：请问公司将所有产能建置在一个厂区内的原因是什么？ 答复：在同一厂区内有序、稳定的扩充产能，能够减少不必要的重复建设，充分利用各项设备和设施，以及进行更优的产能调度，可以显著提升投资效益，能够使公司在维持高产能利用率的同时，实现快速扩张。 问题 5：请问公司今年电源管理芯片进展如何？ 答复：公司已实现 150nm 及 110nm PMIC 的量产，并正积极推行 90nm PMIC 的开发，2025 年上半年电源管理芯片营收占比达 12.07%。 问题 6：公司股权激励的实施情况？ 答复：公司于 2023 年、2025 年分别实施了限制性股票激励计划，目前 2023 年限制性股票激励计划将于 10 月 23 日进入第一个归属期，相关工作正在推进中，具体情况请关注公司后续披露的公告。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 15 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	中泰电子	22	平安资管
2	兴全基金	23	淳厚基金
3	中银国际	24	陆家嘴信托
4	中银电子	25	循理资产
5	国泰海通资管	26	重阳投资
6	宁泉资产	27	磐泽资产
7	前海人寿	28	长城财富保险资管
8	丹羿投资	29	磐厚动量
9	混沌天成国际	30	光大证券
10	兴业证券	31	汇添富基金
11	东方财富	32	国泰基金
12	财通资管	33	众安保险
13	英大信托	34	惠升基金
14	西部利得基金	35	金鹰基金
15	中信资管	36	理成资产
16	鑫元基金	37	同犇投资
17	上海银叶投资	38	广发证券
18	合众易晟	39	财通基金
19	长江证券	40	汇安基金
20	东方阿尔法基金	41	安联基金
21	华泰保兴基金	42	南京证券